

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年10月6日(06.10.2022)



(10) 国際公開番号

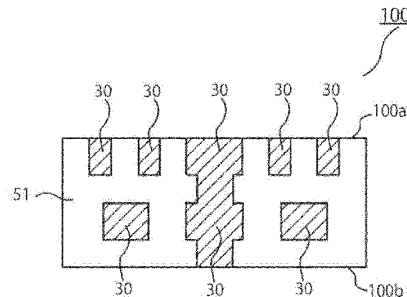
WO 2022/210598 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 23/12 (2006.01) *H05K 3/46* (2006.01) 県川崎市川崎区鈴木町 1 - 2 味の素ファインテクノ株式会社内 Kanagawa (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/015174 (74) 代理人: 弁理士法人酒井国際特許事務所 (SAKAI INTERNATIONAL PATENT OFFICE); 〒1000013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 8 番 1 号 虎の門三井ビルディング Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2022年3月28日(28.03.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-055987 2021年3月29日(29.03.2021) JP
- (71) 出願人: 味の素株式会社 (AJINOMOTO CO., INC.) [JP/JP]; 〒1048315 東京都中央区京橋一丁目 1 5 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小椋 一郎 (OGURA, Ichiro); 〒2100801 神奈川県川崎市川崎区鈴木町 1 - 2 味の素ファインテクノ株式会社内 Kanagawa (JP). 岡崎 大地 (OKAZAKI, Daichi); 〒2100801 神奈川
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: CIRCUIT BOARD MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 回路基板の製造方法

[図23]



(57) Abstract: Provided is a novel circuit board manufacturing method with which it is possible to form a conductor circuit with fine patterns even when an insulating layer contains an inorganic filler. The circuit board manufacturing method comprises the following steps (X), (Y), and (Z): (X) a step for forming a first conductor circuit on a metal layer of a metal layer-attached substrate; (Y) a step for forming a resin composition layer from a resin composition so as to embed the first conductor circuit formed on the metal layer, and forming an insulating layer by curing the resin composition layer; and (Z) a step for removing the metal layer-attached substrate to form a circuit board having a first main surface exposing the first conductor circuit. The resin composition includes an epoxy resin, a curing agent, and an inorganic filler.

[続葉有]

WO 2022/210598 A1

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 絶縁層が無機充填材を含有する場合であっても微細なパターンにて導体回路を形成し得る、新規な回路基板の製造方法を提供する。該回路基板の製造方法は、下記工程 (X)、(Y) 及び (Z):
(X) 金属層付き基材の該金属層上に、第1導体回路を形成する工程 (Y) 前記金属層上に形成された第1導体回路を埋め込むように樹脂組成物により樹脂組成物層を形成し、該樹脂組成物層を硬化させて絶縁層を形成する工程 (Z) 金属層付き基材を除去して、第1導体回路が露出した第1の主面を有する回路基板を形成する工程を含み、樹脂組成物が、エポキシ樹脂、硬化剤及び無機充填材を含む。